

2024年3月期

決算補足資料

2024年5月10日



2024年3月期 通期実績・2025年3月期通期予想 (単位：億円)

	2023年3月期	2024年3月期	増減率	2025年3月期	増減率
	通期実績	通期実績		通期予想	
売上高	1,673	1,795	7.3%	1,950	8.7%
営業利益	96 5.7%	117 6.5%	21.8%	160 8.2%	37.2%
経常利益	112 6.7%	143 8.0%	27.2%	150 7.7%	5.1%
当期純利益	88 5.3%	113 6.3%	27.8%	125 6.4%	10.5%
期中平均為替レート (JPY/USD)	136.0	145.3		145	

商品別売上高シェア

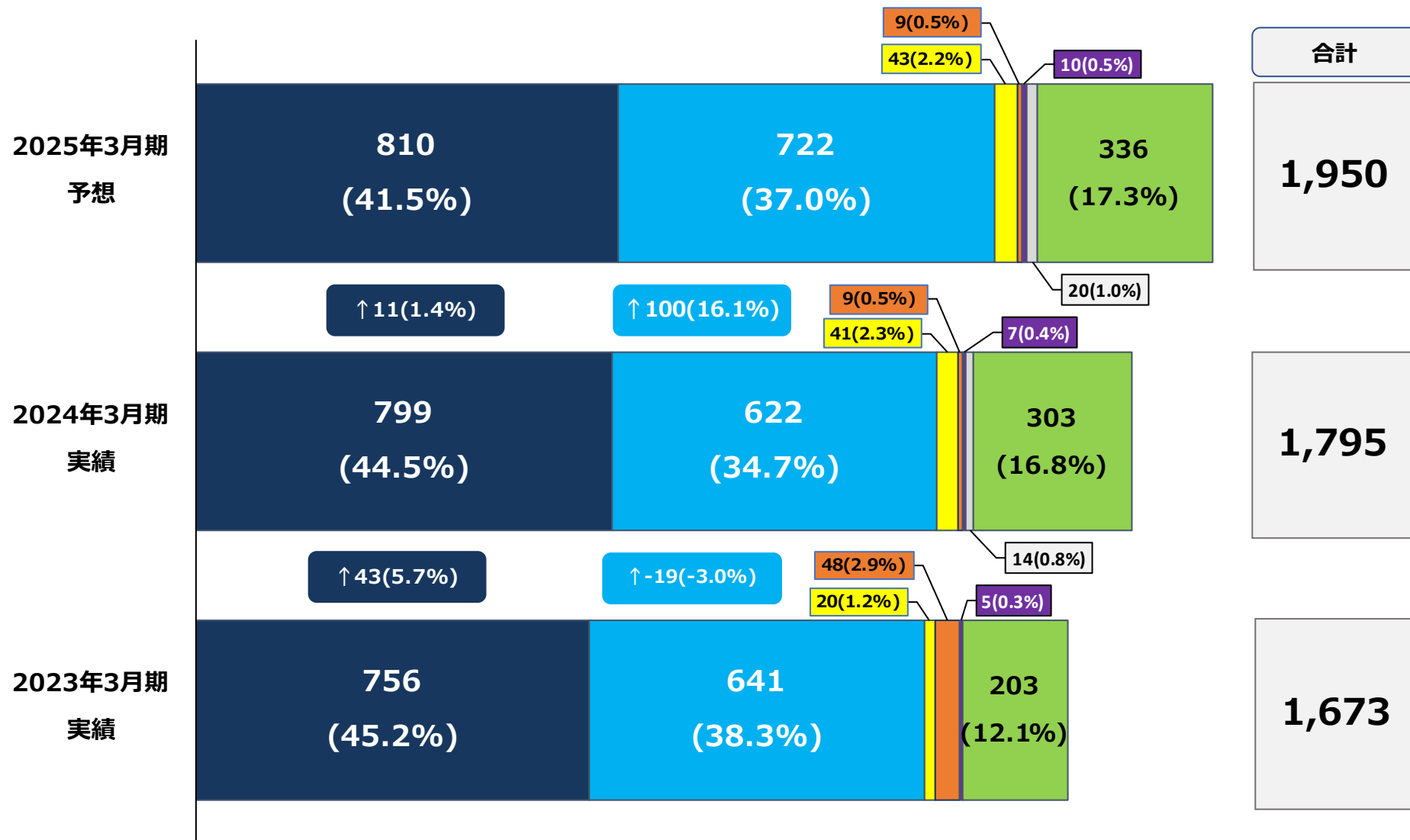
(単位：億円)

	2023年3月期実績		2024年3月期実績		2025年3月期予想	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	845	60 7.1%	947	81 8.6%	969	95 9.8%
スマートフォン タブレット	271	11 4.1%	266	21 7.9%	238	30 12.6%
半導体パッケージ	5	0 0.0%	7	-15 -214.3%	10	-17 -170.0%
SSD IoTモジュール	100	10 10.0%	85	10 11.8%	77	12 15.6%
衛星通信					80	8 10.0%
AI家電 アミューズメント 産機他	249	16 6.4%	187	11 5.9%	240	21 8.8%
EMS 電子機器開発製造	203	-1 -0.5%	303	9 3.0%	336	11 3.3%
合計	1,673	96 5.7%	1,795	117 6.5%	1,950	160 8.2%

仕様別売上高シェア

(単位：億円)

■ 多層貫通基板 ■ ビルドアップ基板 ■ リジットフレキ/フレキ基板 ■ 放熱/大電流/他基板 ■ 半導体パッケージ基板 ■ その他 ■ EMS/電子機器開発製造



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。